

技術術語詞彙表

本技術術語詞彙表載有本文件所用與本公司及我們的業務有關的若干技術術語的詮釋。該等術語及涵義未必與該等術語的標準行業涵義或用法一致。

「2.5D結構」	指	一種先進封裝技術，其將多個集成電路晶片組合在單一封裝中，而無需通過硅通孔將其堆疊成三維集成電路
「3D結構」	指	有源晶片通過晶片堆疊進行集成，以實現最短的互連及最小的封裝尺寸
「5G」	指	第五代蜂巢式網路技術
「AI」	指	人工智能
「BOM」	指	物料清單
「植球」	指	一種先進的晶圓級製造工藝，於單個半導體晶片仍為完整晶圓一部分時，在其焊盤上形成微小的凸起金屬凸塊(如焊球或銅柱)
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「現金轉換週期」	指	公司將其存貨及應收賬款投資轉化為銷售所得現金所需的天數，按存貨週轉天數加應收賬款週轉天數減應付賬款週轉天數計算
「CO ₂ 」	指	二氧化碳(於文內為二氧化碳激光鑽孔)
「CoWoS」	指	基板上晶圓上芯片，一種先進的2.5D封裝技術，其將多個小晶片及高帶寬內存立方體集成到安裝在基板上的硅中介層上
「CRM」	指	客戶關係管理
「直寫光刻技術」	指	(在印製電路板製造領域亦稱「直接成像技術」)乃一種光刻技術，利用經數碼控制的光束或電子束，在毋須使用實體掩膜版情況下，將圖案直接轉移至基板上
「ERP」	指	企業資源規劃
「FC BGA」	指	倒裝芯片／球柵陣列
「FC CSP」	指	倒裝芯片—芯片級封裝

技術術語詞彙表

「FPC」	指	柔性電路板
「FPD」	指	平板顯示器
「GB/T」	指	國標／推薦，推薦性中國國家標準
「GFA」	指	總建築面積
「HDI」	指	高密度互連
「HPC」	指	高效能運算
「IC載板」	指	集成電路載板
「IGBT」	指	絕緣柵雙極電晶體，一種主要構成電子開關的三端功率半導體器件
「物聯網」	指	物聯網
「IPD」	指	一體化產品開發
「LDI」	指	激光直接成像
「LD」	指	激光二極管，一種與發光二極管類似的半導體器件，其中二極管受電流直接泵激，可在二極管的結區產生激光條件
「LED」	指	發光二極體
「MEMS」	指	微機電系統
「MES」	指	製造執行系統
「OLED」	指	有機發光二極管
「PCB」	指	印製電路板
「PLP」	指	面板級先進封裝
「QA」	指	質量保證
「QC」	指	質量控制
「柵格數據」	指	像素網格，其中每個像素儲存一個值(如海拔或溫度)，使其成為表示衛星圖像及高程圖等連續現象的理想選擇，惟於放大時會變得像素化
「研發」	指	研究與開發
「RDL」	指	重佈線層
「Si」	指	硅

技術術語詞彙表

「SiC」	指	碳化硅
「SOP」	指	標準作業程序
「SoW」	指	晶圓上系統，一種先進的半導體封裝技術，其將各種功能小晶片(處理器、內存、加速器)集成到單個完整的硅晶圓上，以創建單個大規模系統，而非獨立芯片
「平方米」	指	平方米，一種面積計量單位
「TGV」	指	玻璃通孔
「TSV」	指	硅通孔
「矢量數據」	指	使用點、線及多邊形表示道路及樓宇等離散的地理特徵，提供高精度及可擴展性而不會損失質量
「WEE」	指	晶圓邊緣曝光
「WEP」	指	晶圓邊緣保護
「WLP」	指	晶圓級封裝